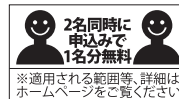




CMP及び周辺の技術・材料に携わる方々は是非
スラリー、パッド、コンディショナー、、、消耗材の開発・評価のヒントを提示

【Live配信】CMP技術および その最適なプロセスを実現するための総合知識 ～装置、スラリー・研磨パッド等の消耗材料の技術、 応用プロセス、研磨メカニズム～

- スラリー技術、パッド技術とその材料・開発・プロセス評価■
- デバイス応用事例、様々な基板研磨技術■
- CMP材料除去メカニズムの変遷と最新モデル■



※適用される範囲等、詳細はホームページをご覧ください

日時 2021年6月25日(金) 10:30～16:30 会場 Live配信セミナー ※会社・自宅にしながら学習可能です※

受講料 49,500円 → テレワーク応援キャンペーン 【Live配信/WEBセミナー受講限定】
1名申込みの場合:受講料 定価:35,200円/※E-Mail案内登録価格 33,440円 資料付
※ E-Mail案内または郵送DM案内の希望を登録の方はE-mail案内登録価格になります。
※ 同一企業で複数名E-Mail案内登録されている場合は、本割引ではなく「2名同時申込みで1名分無料」割引を適用させていただきます。

講師 (株)ISTL 代表取締役社長 博士(工学) 磯部 晶 氏 ※元NEC/東京精密/ニッタハース/ディスコ

趣旨 CMPがデバイスの製造工程に用いられるようになって、すでに四半世紀以上が経過した。当初はゲテモノ扱いされていた CMPも今やなくてはならないキープロセスとなっている。半導体デバイス製造における様々なCMP工程の特徴を紹介し、それに用いられる装置、スラリー、パッドの詳細を解説する。各種基板研磨や新たな応用についても解説する。さらに、CMPによる材料除去のメカニズムについて様々なモデルを紹介し、そこからパッドやスラリーの開発のヒントを提示する。

プログラム	1. CMP装置	3. CMP消耗材料	4.4 ウエハ接合技術とCMP
	1.1 CMP装置の構成	3.1 各種スラリーの基礎	4.5 各種基板CMP
	1.2 ヘッド構造	3.2 砥粒の変遷	
	1.3 終点検出技術	3.3 添加剤の役割	5. CMPの材料除去メカニズム
	1.4 APC	3.4 スラリーの評価方法	5.1 研磨メカニズムモデルの歴史
	1.5 洗浄	3.5 研磨パッドの基礎	5.2 新しいモデル～Ferret径モデル
	2. CMPによる平坦化	3.6 研磨パッドの評価方法	5.3 Ferret径モデルの数値検証
	2.1 CMPによる平坦化工程の分類	3.7 コンディショナーの役割	5.4 Ferret径モデルに基づく開発のヒント
	2.2 平坦化メカニズム	4. CMPの応用	5.5 研磨対象別材料除去メカニズム
		4.1 最新配線構造とCMPの詳細	まとめ
		4.2 最新のトランジスタ構造とCMP	<input type="checkbox"/> 質疑応答
		4.3 3DNANDにおけるCMP	

本セミナーはビデオ会議ツール「Zoom」を使ったライブ配信となります。予め「Zoom」のインストールが可能か、接続可能か等をご確認ください。
・セミナー資料は電子ファイルにてダウンロードいただけます。詳細はホームページをご覧ください。

■2名同時申込みで1名分無料■
(1名あたり定価半額の24,750円)

※2名様ともE-Mail案内登録をしていただいた場合に限りです。 ※他の割引は併用できません。
※同一法人内(グループ会社でも可)による2名同時申込みのみ適用いたします。
※3名様以上のお申込みの場合、左記1名あたりの金額で受講できます。
※受講券、請求書は、代表者にご郵送いたします。
※請求書および領収書は1名様ごとに発行可能です。(通信欄に「請求書1名ごと発行」と記入ください。)

※講師、プログラムの内容が変更になる場合もございます。最新の情報はHPにてご確認ください。 ※申込用紙が複数枚必要な場合等は、本用紙をコピーしてお使いください。

セミナー申込用紙 B210685 (CMP) お申し込みには会員の事前登録が必須となります

会社名 団体名		
部署		
役職	〒	
ふりがな	住所	
氏名		
TEL	FAX	
E-mail	※申込みに関する連絡に使用するため、可能な限りご記入ください。	

※太枠の中をご記入下さい。 ※□にチェックをご記入ください。
※E-mailアドレスまたはFAX番号を必ずご記入下さい。

今後のご案内	
<input type="checkbox"/> E-mail希望・登録済み	E-Mail案内登録価格 を適用いたします。 (E-mailアドレス必須)
<input type="checkbox"/> 郵送希望・登録済み	
<input type="checkbox"/> 希望しない	
お支払方法	
<input type="checkbox"/> 銀行振込 (振込予定日 月 日)	
通信欄	

●受講料について
「2名同時申込みで1名分無料」については上記の注意事項をお読みください。
●お申込みについて
申込用紙に必要事項をご記入のうえ、FAXでお申込みください。
また、当社ホームページからでもお申込みいただけます。
お申込みを確認次第、請求書・受講券・会場案内図をお送りします。
●お支払いについて
受講料は、銀行振込(原則として開催日まで)、もしくは当日現金にてお支払いください。
銀行振込の場合、原則として領収書の発行はいたしません。
振込手数料はお客様がご負担ください。

●個人情報の取り扱いについて
ご記入いただいた個人情報は、事務連絡・発送の他、情報案内等に使用いたします。
詳しくはホームページをご覧ください。
●キャンセル規定
開催日から逆算(営業日:土日・祝祭日を除く)いたしまして、
・開催7日前以前でのキャンセル: キャンセル料はいただきません。
・開催3～6日前でのキャンセル: 受講料の70%
・開催当日～2日前でのキャンセル・欠席: 受講料の100%
※ご注意※ 参加者が最少催行人数に達しない場合など、事情により中止になる場合がございます。

サイエンス & テクノロジー
研究・技術・事業開発のためのセミナー/書籍
サイエンス&テクノロジー株式会社
TEL 03-5733-4188 FAX 03-5733-4187
〒105-0013
東京都港区浜松町1-2-12 浜松町F-1ビル7F
https://www.science-t.com